

证券代码： 301418

证券简称： 协昌科技

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	调研人员： 信达澳亚基金 张恒海 信达澳亚基金 孔文彬 信达澳亚基金 童昌希 国金证券 邓超瑜
时间	2024 年 12 月 30 日上午 10:00-11:00
地点	公司 1 号楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书孙贝（代） 财务负责人曾骁 证券事务代表蒋仕达
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 客户集中度情况？前五大客户份额占比？</p> <p>公司运动控制产品的下游客户主要为一线品牌整车厂商，下游中大型整车厂商在行业中具有较强的竞争优势，因此公司控制器产品下游客户相对集中；公司功率芯片业务产品具有一定的通用性，产品适用于下游运动控制产品、消费电子等产品，该等终端用户群体较为广泛，集中度相对较低。根据公司 2023 年度报告，前五大客户营收占比为 68.23%。</p> <p>2. 国内目前整车厂海外市场的发展情况？</p> <p>在“碳中和”大背景下，海外电动两轮车市场需求持续升温。</p> <p>目前，国内电动车下游厂商纷纷布局海外市场，积极拓展国际业务版图。根据公开资料显示，雅迪已在越南和印尼</p>

成功建立生产基地；爱玛设立了印尼爱玛、越南爱玛、新加坡爱玛三家海外全资子公司；新日的印尼生产基地建设及渠道网络建设在稳步推进中。

3. 公司产品升级方向？

公司主要聚焦于运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售，自上市以来持续加大研发投入，强化人才梯队建设，立足于上游功率芯片、下游运动控制产品协同发展的优势，紧跟客户需求和市场动向进行产品升级。

在控制器产品方面，加大智能化、大功率产品的研发投入，助力下游行业智能化、高端化发展进程；在功率芯片方面，积极开发产品新应用领域，同时拟通过募投项目实现向封装环节的业务延伸，进一步提升公司产品的稳定性和成本竞争优势，围绕主业，做大做强，提升市场占有率。

公司坚持不断创新、积极开拓，以技术驱动业务发展，强化新产品开发力度，积极开拓新的应用领域。

4. 公司的核心竞争力在哪里？有哪些核心技术？

(1) 核心竞争力方面

① 上下游协同能力

公司是行业内少数几家拥有电力电子产业链纵向布局的企业之一，同时具备上游功率芯片及下游运动控制产品的开发能力，形成了良好的上下游协同效应。

功率芯片是运动控制器的主要原材料之一，功率芯片的选择一定程度上会对运动控制器的技术性能、整体成本造成重大影响。而功率芯片的开发则需要关注应用匹配，不同的应用场景对功率芯片的各项性能参数要求有一定差异。公司凭借产业链一体化的优势，上下游协同开发，功率芯片开发有明确的匹配参数需求和目标，运动控制器能够为功率芯片的持续优化提供应用场景和大量的分析数据，有利于产品快

	<p>速推广，经过长期应用及验证，一方面，功率芯片良好的匹配性能保障了控制器产品的可靠性和稳定性；另一方面，在市场端也赢得了下游客户的信任及认可。</p> <p>②运动控制产品的软硬件同步研发能力</p> <p>公司具备软硬件同步开发能力，公司面向电动两三轮车市场自主研发并推出的矢量变频控制方案、有感及无感多模一体的控制算法等，均取得了积极的市场反馈。</p> <p>(2) 核心技术方面</p> <p>公司致力于从“软件+硬件”两方面建立和巩固产品技术优势，软件方面，公司自主研发并推出了矢量变频控制方案、有感及无感多模一体的控制算法等，控制信号输出较为稳定、运行效率较高，有效降低运行噪音和性能损耗；硬件方面，公司深入 MCU 参数定义、电子线路布图及应用功能拓展等方面的研究，自主研发并形成了大电流电子线路布线、MOSFET 并联均流等核心技术，有效提升产品性能及稳定性。</p> <p>5、公司业务发展是否有新的拓展？未来预期发展规划？</p> <p>公司加快创新业务发展，在稳固主营业务拓展的同时，聚焦于功率芯片、马达驱动与控制、系统集成整合等技术领域，立足于功率芯片与运动控制器产品上下游协同的优势，围绕客户需求和市场动向开展业务布局。</p> <p>2023 年 12 月，公司先后成立了协昌电驱动科技（苏州）有限公司以及凯美半导体（苏州）有限公司，加大公司智能化、大功率控制器产品的研发投入，同时实现向封装环节的业务延伸。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 30 日